

半導体パッケージビジネス戦略2022

目次

1. パッケージビジネスの現状と展望

1-1 パッケージビジネスの現状と展望	2	6) 工場別提供パッケージ	48
1-1-1 世界半導体産業の売上推移と展望	3	7) 各工場のライン別一覧	49
1-1-2 世界半導体後工程市場・世界OSAT上位20社の売上推移と展望	3	2-5 シャープ株式会社	58
1-1-3 世界パッケージ市場・世界OSAT上位20社の売上推移と展望	4	1) 事業戦略	58
1-1-4 世界OSAT上位20社の売上推移と展望	4	2) 設備投資	59
1-1-5 世界OSAT上位20社の企業別売上実績	5	3) 開発と今後の方向性	59
1-1-6 世界OSAT上位20社の国籍別社数構成比	6	4) 半導体売上状況	60
1-1-7 世界OSAT上位20社の国籍別売上構成比(2020年度)	6	5) 設備投資状況	60
1-2 後工程製造拠点および設備投資状況	7	6) 工場別提供パッケージ	61
1-2-1 後工程工場世界分布(日本を除く)	8	7) 各工場のライン別一覧	62
1-2-2 世界OSAT上位20社の後工程工場世界分布(日本を除く)	8	2-6 三菱電機株式会社	66
1-2-3 世界半導体設備投資の推移と展望	9	1) 事業戦略	66
1-2-4 世界半導体後工程設備投資の推移と展望	9	2) 設備投資	67
1-2-5 世界OSAT上位20社の企業別後工程設備投資実績	10	3) 開発と今後の方向性	67
1-2-6 世界OSAT上位20社の国籍別設備投資構成比(2020年度)	10	4) 半導体売上状況	68

2. 国内半導体企業のパッケージ事業戦略

2-1 東芝デバイス&ストレージ株式会社・キオクシア株式会社	12	6) 工場別提供パッケージ	81
1) 事業戦略	12	7) 各工場のライン別一覧	82
2) 設備投資	13	2-8 サンケン電気株式会社	89
3) 開発と今後の方向性	14	1) 事業戦略	89
4) 半導体売上状況	15	2) 設備投資	90
5) 設備投資状況	15	3) 開発と今後の方向性	90
6) 工場別提供パッケージ	16	4) 半導体売上状況	91
7) 各工場のライン別一覧	17	5) 設備投資状況	91
2-2 ソニー株式会社	23	6) 工場別提供パッケージ	92
1) 事業戦略	23	7) 各工場のライン別一覧	93
2) 設備投資	24	2-9 浜松ホトニクス株式会社	101
3) 開発と今後の方向性	24	1) 事業戦略	101
4) 半導体売上状況	26	2) 設備投資	102
5) 設備投資状況	26	3) 開発と今後の方向性	102
6) 工場別提供パッケージ	27	4) 半導体売上状況	103
7) 各工場のライン別一覧	28	5) 設備投資状況	103
2-3 ルネサスエレクトロニクス株式会社	32	6) 工場別提供パッケージ	104
1) 事業戦略	32	7) 各工場のライン別一覧	105
2) 設備投資	33	2-10 ミネベアミツミ株式会社	110
3) 開発と今後の方向性	33	1) 事業戦略	110
4) 半導体売上状況	34	2) 設備投資	111
5) 設備投資状況	34	3) 開発と今後の方向性	111
6) 工場別提供パッケージ	35	4) 半導体売上状況	112
7) 各工場のライン別一覧	36	5) 設備投資状況	112
2-4 ローム株式会社	44	6) 工場別提供パッケージ	113
1) 事業戦略	44	7) 各工場のライン別一覧	114
2) 設備投資	45	2-11 セイコーエプソン株式会社	116
3) 開発と今後の方向性	45	1) 事業戦略	116
4) 半導体売上状況 - (1)全社製品別	46	2) 設備投資	116
4) 半導体売上状況 - (2)後工程関連	46	3) 開発と今後の方向性	116
5) 設備投資状況 - (1)全社製品別	47	4) 半導体売上状況	117
5) 設備投資状況 - (2)後工程関連	47	5) 設備投資状況	117
		6) 工場別提供パッケージ	118

7) 各工場のライン別一覧	119	1) 事業戦略	172
2-12 日清紡マイクロデバイス株式会社	122	2) 設備投資	173
1) 事業戦略	122	3) 開発と今後の方向性	174
2) 設備投資	123	4) 半導体売上状況	176
3) 開発と今後の方向性	123	5) 設備投資状況	176
4) 半導体売上状況	124	6) 工場別提供パッケージ	177
5) 設備投資状況	124	7) 各工場のライン別一覧	178
6) 工場別提供パッケージ	125	3-2 Micron Technology	184
7) 各工場のライン別一覧	126	1) 事業戦略	184
2-13 新電元工業株式会社	128	2) 設備投資	185
1) 事業戦略	128	3) 開発と今後の方向性	185
2) 設備投資	128	4) 半導体売上状況	186
3) 開発と今後の方向性	129	5) 設備投資状況	186
4) 半導体売上状況	130	6) 工場別提供パッケージ	187
5) 設備投資状況	130	7) 各工場のライン別一覧	188
6) 工場別提供パッケージ	131	3-3 Texas Instruments	193
7) 各工場のライン別一覧	132	1) 事業戦略	193
2-14 スタンレー電気株式会社	136	2) 設備投資	194
1) 事業戦略	136	3) 開発と今後の方向性	194
2) 設備投資	137	4) 半導体売上状況	195
3) 開発と今後の方向性	137	5) 設備投資状況	195
4) 半導体売上状況	138	6) 工場別提供パッケージ	196
5) 設備投資状況	138	7) 各工場のライン別一覧	197
6) 工場別提供パッケージ	139	3-4 Analog Devices	203
7) 各工場のライン別一覧	140	1) 事業戦略	203
2-15 コーデンシ株式会社	144	2) 設備投資	204
1) 事業戦略	144	3) 開発と今後の方向性	204
2) 設備投資	145	4) 半導体売上状況	205
3) 開発と今後の方向性	145	5) 設備投資状況	205
4) 半導体売上状況	146	6) 工場別提供パッケージ	206
5) 設備投資状況	146	7) 各工場のライン別一覧	207
6) 工場別提供パッケージ	147	3-5 ON Semiconductor	210
7) 各工場のライン別一覧	148	1) 事業戦略	210
2-16 京セラ株式会社	151	2) 設備投資	211
1) 事業戦略	151	3) 開発と今後の方向性	212
2) 設備投資	151	4) 半導体売上状況	213
3) 開発と今後の方向性	152	5) 設備投資状況	213
4) 半導体売上状況	153	6) 工場別提供パッケージ	214
5) 設備投資状況	153	7) 各工場のライン別一覧	215
6) 工場別提供パッケージ	154	3-6 Samsung Electronics	226
7) 各工場のライン別一覧	155	1) 事業戦略	226
2-17 株式会社京都セミコンダクター	158	2) 設備投資	227
1) 事業戦略	158	3) 開発と今後の方向性	227
2) 設備投資	159	4) 半導体売上状況	228
3) 開発と今後の方向性	159	5) 設備投資状況	228
4) 半導体売上状況	160	6) 工場別提供パッケージ	229
5) 設備投資状況	160	7) 各工場のライン別一覧	230
6) 工場別提供パッケージ	161	3-7 SK Hynix	233
7) 各工場のライン別一覧	162	1) 事業戦略	233
2-18 株式会社オリジン	164	2) 設備投資	234
1) 事業戦略	164	3) 開発と今後の方向性	234
2) 設備投資	164	4) 半導体売上状況	235
3) 開発と今後の方向性	165	5) 設備投資状況	235
4) 半導体売上状況	166	6) 工場別提供パッケージ	236
5) 設備投資状況	166	7) 各工場のライン別一覧	237
6) 工場別提供パッケージ	167	3-8 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation)	240
7) 各工場のライン別一覧	168	1) 事業戦略	240
		2) 設備投資	241
		3) 開発と今後の方向性	242
		4) 半導体売上状況	243
		5) 設備投資状況	243
3. 海外半導体企業のパッケージ事業戦略			
3-1 Intel Corporation	172		

6) 工場別提供パッケージ	244	4-5 エムテックスマツムラ株式会社	318
7) 各工場のライン別一覧	245	1) 事業戦略	318
3-9 STMicroelectronics	249	2) 設備投資	318
1) 事業戦略	249	3) 開発と今後の方向性	319
2) 設備投資	250	4) 半導体売上状況	320
3) 開発と今後の方向性	250	5) 設備投資状況	320
4) 半導体売上状況	252	6) 工場別提供パッケージ	321
5) 設備投資状況	252	7) 各工場のライン別一覧	322
6) 工場別提供パッケージ	253	4-6 株式会社ミスズ工業	326
7) 各工場のライン別一覧	254	1) 事業戦略	326
3-10 Infineon Technologies	261	2) 設備投資	326
1) 事業戦略	261	3) 開発と今後の方向性	327
2) 設備投資	262	4) 半導体売上状況	328
3) 開発と今後の方向性	263	5) 設備投資状況	328
4) 半導体売上状況	264	6) 工場別提供パッケージ	329
5) 設備投資状況	264	7) 各工場のライン別一覧	330
6) 工場別提供パッケージ	265	4-7 東洋電子工業株式会社	332
7) 各工場のライン別一覧	266	1) 事業戦略	332
3-11 NXP Semiconductors	280	2) 設備投資	332
1) 事業戦略	280	3) 開発と今後の方向性	332
2) 設備投資	281	4) 半導体売上状況	333
3) 開発と今後の方向性	281	5) 設備投資状況	333
4) 半導体売上状況	282	6) 工場別提供パッケージ	334
5) 設備投資状況	282	7) 各工場のライン別一覧	335
6) 工場別提供パッケージ	283	4-8 株式会社野田市電子	338
7) 各工場のライン別一覧	284	1) 事業戦略	338
		2) 設備投資	338
		3) 開発と今後の方向性	338
		4) 半導体売上状況	339
		5) 設備投資状況	339
		6) 工場別提供パッケージ	340
		7) 各工場のライン別一覧	341
		4-9 大津電子株式会社	343
		1) 事業戦略	343
		2) 設備投資	343
		3) 開発と今後の方向性	343
		4) 半導体売上状況	344
		5) 設備投資状況	344
		6) 工場別提供パッケージ	345
		7) 各工場のライン別一覧	346

4. 国内OSAT企業のパッケージ事業戦略

4-1 アオイ電子株式会社	290
1) 事業戦略	290
2) 設備投資	291
3) 開発と今後の方向性	291
4) 半導体売上状況	292
5) 設備投資状況	292
6) 工場別提供パッケージ	293
7) 各工場のライン別一覧	294
4-2 新光電気工業株式会社	298
1) 事業戦略	298
2) 設備投資	299
3) 開発と今後の方向性	299
4) 半導体売上状況	300
5) 設備投資状況	300
6) 工場別提供パッケージ	301
7) 各工場のライン別一覧	302
4-3 株式会社加藤電器製作所	303
1) 事業戦略	303
2) 設備投資	304
3) 開発と今後の方向性	304
4) 半導体売上状況	305
5) 設備投資状況	305
6) 工場別提供パッケージ	306
7) 各工場のライン別一覧	307
4-4 内藤電誠グループ	311
1) 事業戦略	311
2) 設備投資	312
3) 開発と今後の方向性	312
4) 半導体売上状況	313
5) 設備投資状況	313
6) 工場別提供パッケージ	314
7) 各工場のライン別一覧	315

5. 海外OSAT企業のパッケージ事業戦略

5-1 ASE (Advanced Semiconductor Engineering)	348
1) 事業戦略	348
2) 設備投資	349
3) 開発と今後の方向性	349
4) 半導体売上状況	351
5) 設備投資状況	351
6) 工場別提供パッケージ	352
7) 各工場のライン別一覧	353
5-2 Amkor Technology	367
1) 事業戦略	367
2) 設備投資	368
3) 開発と今後の方向性	369
4) 半導体売上状況	371
5) 設備投資状況	371
6) 工場別提供パッケージ	372
7) 各工場のライン別一覧	373
5-3 JCET Group	392
1) 事業戦略	392

2) 設備投資	393	1) 事業戦略	492
3) 開発と今後の方向性	394	2) 設備投資	493
4) 半導体売上状況	396	3) 開発と今後の方向性	493
5) 設備投資状況	396	4) 半導体売上状況	494
6) 工場別提供パッケージ	397	5) 設備投資状況	494
7) 各工場のライン別一覧	398	6) 工場別提供パッケージ	495
5-4 Powertech Technology	404	7) 各工場のライン別一覧	496
1) 事業戦略	404	5-12 HANA Micron	497
2) 設備投資	405	1) 事業戦略	497
3) 開発と今後の方向性	406	2) 設備投資	498
4) 半導体売上状況	408	3) 開発と今後の方向性	498
5) 設備投資状況	408	4) 半導体売上状況	500
6) 工場別提供パッケージ	409	5) 設備投資状況	500
7) 各工場のライン別一覧	410	6) 工場別提供パッケージ	501
5-5 Tongfu Microelectronics (通富微電子)	424	7) 各工場のライン別一覧	502
1) 事業戦略	424	5-13 Carsem	506
2) 設備投資	425	1) 事業戦略	506
3) 開発と今後の方向性	426	2) 設備投資	507
4) 半導体売上状況	427	3) 開発と今後の方向性	507
5) 設備投資状況	427	4) 半導体売上状況	508
6) 工場別提供パッケージ	428	5) 設備投資状況	508
7) 各工場のライン別一覧	429	6) 工場別提供パッケージ	509
5-6 Tianshui Huatian Technology (TSHT)	436	7) 各工場のライン別一覧	510
1) 事業戦略	436	5-14 Formosa Advanced Technologies (FATC)	513
2) 設備投資	437	1) 事業戦略	513
3) 開発と今後の方向性	438	2) 設備投資	514
4) 半導体売上状況	439	3) 開発と今後の方向性	514
5) 設備投資状況	439	4) 半導体売上状況	515
6) 工場別提供パッケージ	440	5) 設備投資状況	515
7) 各工場のライン別一覧	441	6) 工場別提供パッケージ	516
5-7 ChipMOS Technologies	450	7) 各工場のライン別一覧	517
1) 事業戦略	450	5-15 Nepes	518
2) 設備投資	451	1) 事業戦略	518
3) 開発と今後の方向性	451	2) 設備投資	519
4) 半導体売上状況	453	3) 開発と今後の方向性	520
5) 設備投資状況	453	4) 半導体売上状況	521
6) 工場別提供パッケージ	454	5) 設備投資状況	521
7) 各工場のライン別一覧	455	6) 工場別提供パッケージ	522
5-8 Chipbond Technology	460	7) 各工場のライン別一覧	523
1) 事業戦略	460	5-16 Suzhou Good-Ark Electronics	529
2) 設備投資	461	1) 事業戦略	529
3) 開発と今後の方向性	461	2) 設備投資	529
4) 半導体売上状況	462	3) 開発と今後の方向性	530
5) 設備投資状況	462	4) 半導体売上状況	531
6) 工場別提供パッケージ	463	5) 設備投資状況	531
7) 各工場のライン別一覧	464	6) 工場別提供パッケージ	532
5-9 UTAC	469	7) 各工場のライン別一覧	533
1) 事業戦略	469	5-17 Walton Advanced Engineering	535
2) 設備投資	470	1) 事業戦略	535
3) 開発と今後の方向性	471	2) 設備投資	536
4) 半導体売上状況	473	3) 開発と今後の方向性	536
5) 設備投資状況	473	4) 半導体売上状況	537
6) 工場別提供パッケージ	474	5) 設備投資状況	537
7) 各工場のライン別一覧	475	6) 工場別提供パッケージ	538
5-10 SFA Semicon	483	7) 各工場のライン別一覧	539
1) 事業戦略	483	5-18 Signetics	544
2) 設備投資	484	1) 事業戦略	544
3) 開発と今後の方向性	484	2) 設備投資	544
4) 半導体売上状況	486	3) 開発と今後の方向性	545
5) 設備投資状況	486	4) 半導体売上状況	546
6) 工場別提供パッケージ	487	5) 設備投資状況	546
7) 各工場のライン別一覧	488	6) 工場別提供パッケージ	547
5-11 OSE (Orient Semiconductor Electronics)	492	7) 各工場のライン別一覧	548

5-19 China Wafer Level CSP	549
1) 事業戦略	549
2) 設備投資	549
3) 開発と今後の方向性	550
4) 半導体売上状況	551
5) 設備投資状況	551
6) 工場別提供パッケージ	552
7) 各工場のライン別一覧	553